

MiniLab-S125A multi-cathode sputtering system

MiniLab-S125A【多元マルチスパッタ装置】

【6元マルチスパッタ装置(Φ2inchカソード)】

【4元マルチスパッタ装置(Φ4inchカソード)】

コンパクトサイズ (1,767 x 754mm) システムに、カソード最大 4 元、又は 6 元搭載、多元マルチスパッタ装置。連続多層膜、同時成膜 (2~6 元同時成膜)、抵抗加熱蒸着・有機蒸着・EB・ドライエッチング、PECVD、アニールなどの混在構成も可能です。



Load Lock チャンバー

- RIEプラズマエッチングステージ
メインチャンバー, LL室いずれも可能
- ・RF150W, 300W, 又はDC780W
- ・<30W低出力制御ソフトエッチング



マグネトロンスパッタリングカソード

- マルチスパッタカソード(DC, RF兼用)
- 4元同時スパッタ

MiniLab-S125A 多元マルチスパッタリング装置

寸法: 1,767(W) x 754(D) x 1,645(H)mm



MiniLab-S125A スパッタリング装置

【チャンバー仕様】

- 500(W) x 500(D) x 650(H)
- SUS304フロントローディング式
- Φ90mmビューポート x 1(又は2)
- 到達真空度 5×10^{-5} Pascal

【基板ステージ】

- 4inch~Φ12inch基板対応
- 基板回転(回転速度20段階速度可変式)
- 基板加熱ヒーター
500℃ハロゲンランプヒーター
1000℃C/Cコンポジット、又はSiCコーティング

【マグネトロンスパッタリング】

- Φ2inchマグネトロンカソード x 最大6元
- Φ3inchカソードの場合 x 最大4元
- Φ4inchカソードの場合 x 最大4元
- 磁性材料用高強度マグネット(オプション)
- 水冷式、傾斜・上下摺動式フレキシブルアングルヘッド

【スパッタ電源】

- RF150W, 300W, 又はDC780W
- HiPIMS電源(PulseDC 5KW)も併設可能

* プラズマリレー SW で HMI 画面より自在に 6 カソードへの電源分配・配置設定の変更が可能

RIE プラズマエッチングステージ

- RF150W, 300W, 又はDC780W
 - <30W低出力制御ソフトエッチング
- *メインチャンバ、LLチャンバー共搭載可能です。

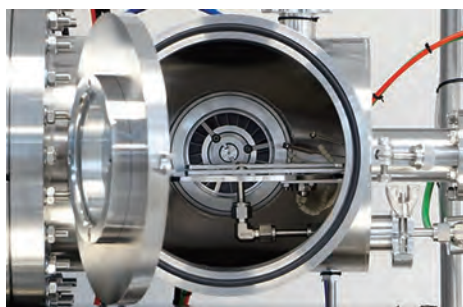
その他仕様

- MFCガス x 標準3系統(Ar, O₂, N₂)
- APC自動圧力制御
- ポンプ:TMP +ロータリー(又はドライスクロール)
- ワイドレンジゲージ・キャパシタンスマノメータ
- 基板シャッター、ソースシャッター
- 水晶振動子膜厚センサー
- SQC-310薄膜コントローラー

Windows-PC で一元管理：バルブ操作・成膜操作（カソード ON/OFF・シャッター開閉・回転等）、真空 / パージ等全ての装置操作を PC インターフェイス 1 箇所で行いますので、操作が分散しません。



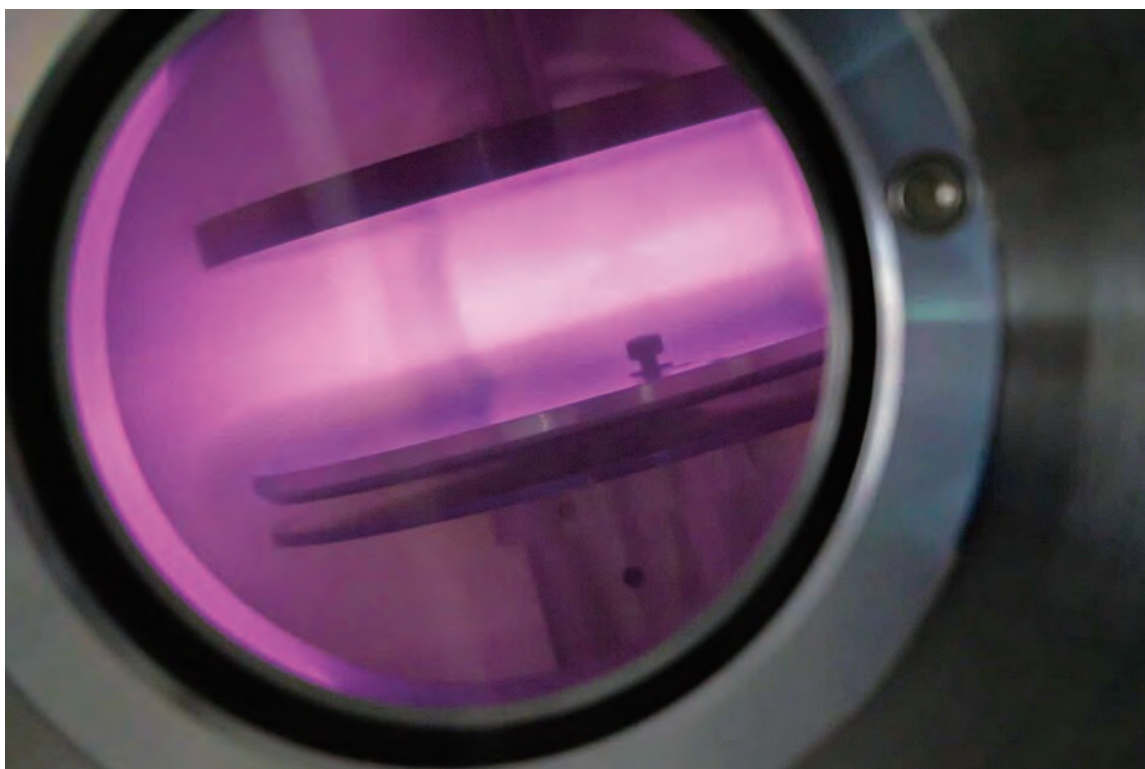
スパッタリングカソード



ロードロック搬送機構



基板加熱ヒーター (SiCコーティング)



RIEプラズマエッチングステージ(メインチャンバー, LL室いずれも可能)

- ・RF150W, 300W, 又はDC780W
- ・<30W低出力制御ソフトエッチング

装置外形寸法

